

PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 44, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013 (*)

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR e DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 6º do art. 7º do Decreto-Lei nº 288, de 28 de fevereiro de 1967, no § 1º do art. 2º, e nos artigos 13 a 16 do Decreto nº 6.008, de 29 de dezembro de 2006, e o que consta no Processo MDIC nº 52000.001052/2005-10, de 13 de janeiro de 2005, resolvem:

Art. 1º O Processo Produtivo Básico para os BENS DE INFORMÁTICA, industrializados na Zona Franca de Manaus, estabelecido pela Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 162, de 27 de junho de 2012, passa a ser o seguinte:

I - montagem e soldagem de todos os componentes nas placas de circuito impresso;

II - montagem das partes elétricas e mecânicas, totalmente desagregadas, em nível básico de componentes; e

III - integração das placas de circuito impresso e das demais partes elétricas e mecânicas na formação do produto final, montadas de acordo com os incisos I e II acima.

§ 1º Desde que obedecido o Processo Produtivo Básico, as atividades ou operações inerentes às etapas de produção poderão ser realizadas por terceiros, no País, exceto a etapa descrita no inciso III que não poderá ser objeto de terceirização.

§ 2º Quando o BEM DE INFORMÁTICA a que se refere esta Portaria não contiver placas de circuito impresso com componentes montados, a etapa constante do inciso I poderá ser dispensada, permanecendo obrigatórias as demais etapas..

§ 3º Até 31 de dezembro de 2012, não descaracteriza o atendimento ao Processo Produtivo Básico definido nesta Portaria a inclusão, em um mesmo corpo ou gabinete de um bem de informática, de unidades de discos magnéticos, ópticos e fonte de alimentação que não tenham cumprido o Processo Produtivo Básico estabelecido nesta Portaria.

§ 4º A partir de 1º de janeiro de 2013, as FONTES DE ALIMENTAÇÃO, CONVERSORES DE CORRENTE CONTÍNUA (CA-CC) OU CARREGADORES DE BATERIA, quando forem externas ou quando estiverem contidas no mesmo corpo ou gabinete de um BEM DE INFORMÁTICA, deverão ser produzidos atendendo às etapas estabelecidas no caput deste artigo, num percentual mínimo de 80% (oitenta por cento), tomando-se por base a quantidade total produzida, no ano calendário.

§ 5º Quando as FONTES DE ALIMENTAÇÃO, CONVERSORES DE CORRENTE CONTÍNUA (CA-CC) OU CARREGADORES DE BATERIA a que se refere o § 4º forem destinadas a MONITORES DE VÍDEO PARA USO EM INFORMÁTICA, as mesmas deverão atender ao seguinte cronograma de montagem mínima:

I - de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013: 30% (trinta por cento); e

II - de 1º de janeiro de 2014 em diante: 80% (oitenta por cento).

§ 6º Caso os percentuais estabelecidos nos §§ 4º e 5º não sejam alcançados no período previsto, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença residual, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano seguinte, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 7º A diferença residual a que se refere o § 6º não poderá exceder a 10% (dez por cento), tomando-se por base a produção do ano em que não foi possível atingir o limite estabelecido.

Art. 2º Ficam temporariamente dispensados de montagem os seguintes módulos ou subconjuntos:

1. Banco de martelos para impressoras de linha
2. Cabeça de impressão térmica
3. Conjunto de espelhos e conjunto óptico para leitor de código de barras
4. Gabinete superior com visor de vidro destinado à fabricação de leitor de código de barras vertical, fixo, do tipo mesa ou balcão
5. Mecanismo impressor com largura de impressão de até 6 (seis) cm
6. Mecanismo impressor e leitor de cartão magnético para dispensadores automáticos de papel-moeda - cash dispenser ou terminal de auto-atendimento ATM (Automatic teller machine)
7. Mecanismo impressor/leitor motorizado de bilhete magnético
8. Mecanismo para aparelhos de fac-símile com impressão por sistema térmico ou a laser, mecanismo para aparelhos digitalizadores de imagens - scanner, mecanismo para aparelhos digitalizadores de imagens - scanner utilizado em subconjuntos depositários de cheques e envelopes
9. Mecanismo para impressora a laser, LED - Diodos emissores de luz ou LCS - Sistema de cristal líquido - engine
10. Microprocessador montado em placa com barramento de conexão à placa mãe com mais de duzentas vias, condicionadas ou não em cartucho
11 . Modulador/demodulador de rádio frequência denominado tuner
12. Módulo SOM (System on module) com circuito lógico e/ou de rádio frequência integrado próprio para conexão à placa de circuito impresso através de processo de montagem por superfície – SMT (Surface Mounted Technology)
13. Módulo de comunicação Bluetooth próprio para conexão à placa de circuito impresso através de processo de montagem por superfície - SMT (Surface Mounted Technology)
14. Módulo display de cristal líquido - LCD, com placa de controle integrada
15. Módulo GPS - Sistema de posicionamento global
16. Módulo leitor de cartão inteligente - smart card
17. Módulo leitor de código de barras para terminais de auto-atendimento
18. Módulo dispositivo ou subconjunto de mostrador de cristal líquido, plasma ou diodo emissor de luz - LED e outras tecnologias de displays
19. Módulo sensor de proximidade
20. Módulo Sensor Biométrico
21. Módulo Sensor Sísmico
22. Módulo tiristor simétrico de potência, tipo SGCT (Symmetrical Gate Commutated Thyristors), com características técnicas de 6.500 V e 400-800A, para utilização em Inversor de Frequência de Média Tensão
23. Padrão de grandezas elétricas e sensor fotoelétrico para aquisição de pulsos
24. Painel de operação e controle para impressoras, mesmo incorporando dispositivo de visualização
25. Placa de circuito impresso montada com componentes elétricos ou eletrônicos que implemente função de processamento central, do tipo industrial, que suporte temperaturas de operação superiores a 60° C, para utilização em sistemas de medição de energia elétrica
26. Teclado e visor para aparelhos de fac-símile
27. Tubo de raios catódicos policromático, mesmo com bobina de deflexão e dispositivos de ajuste de convergência incorporados
28. Tubo de raios catódicos policromático, mesmo com bobina de deflexão, dispositivos de ajuste de convergência e transdutores com cabo de comunicação

incorporados, para monitores de vídeo com tela tipo touch screen
29. Unidade de fita magnética tipo DAT - Fita digital de áudio
30. Subconjunto óptico montado destinado às unidades de saída por vídeo, para máquinas automáticas para processamento de dados, com tecnologia de micro-espelho e processador digital de luz, contendo disco de cores do tipo Disco de Newton, lâmpada ou LCD ou LED, lentes e espelhos ópticos.
31. Placa de circuito impresso montada com componentes elétricos ou eletrônicos que implemente a função de transmissão e recepção de sinais infra-vermelhos em monitores de vídeo igual ou acima de 40" com função de tela sensível ao toque.
32. Unidade de disco magnético.
33. Unidade de disco óptico.
34. Módulo de diodo a laser destinado a aparelho eletro médico para cirurgia via emissão a laser
35. Módulo sensor de imagem destinado a leitores automático de cheques e documentos, com/sem leitor de códigos de barras e de smart card com/sem impressão inkjet.

§ 1º Para o cumprimento do disposto no caput ficam dispensados da montagem, no período compreendido entre 1o de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2013, os leitores de cartão de memória e as placas e partes eletromecânicas sem função ativa, com ou sem filtros de sinal, com objetivo de suportar mecanicamente conectores, entradas de USB, diodos emissores de luz - LED (Light Emitting Diode), chaves liga-desliga ou cabos, utilizados unicamente como extensão de função já implementada na placa-mãe.

§ 2º As placas de interfaces de comunicação com tecnologia sem fio (Wi-Fi, Bluetooth, WiMax), destinadas aos BENS DE INFORMÁTICA, deverão atender ao seguinte cronograma de montagem tomando-se como base a quantidade dessas placas utilizadas no ano calendário:

I - de 1º de janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2010: dispensado.

II - de 1º de janeiro de 2011 a 31 de dezembro de 2011: 20% (vinte por cento);

III - de 1º de janeiro de 2012 a 31 de dezembro de 2013: 50% (cinquenta por cento); e

IV - de 1º de janeiro de 2014 em diante: 80% (oitenta por cento).

§ 3º Caso os percentuais estabelecidos no § 2o não sejam alcançados nos períodos previstos, a empresa ficará obrigada a cumprir a diferença residual, em unidades produzidas, até 31 de dezembro do ano seguinte, sem prejuízo das obrigações correntes.

§ 4º A diferença residual a que se refere o § 3o não poderá exceder a 10% (dez por cento), tomando-se por base a produção do ano em que não foi possível atingir o limite estabelecido.

§ 5º As câmeras de vídeo ou placas de circuito impresso montadas com componentes elétricos ou eletrônicos que implementem a função de câmera de vídeo utilizadas na produção de MÁQUINA AUTOMÁTICA DIGITAL PARA PROCESSAMENTO DE DADOS, COM TELA INCORPORADA - "ALL IN ONE", deverão atender ao seguinte cronograma:

I - para o período anterior a 16 de fevereiro de 2012: dispensada; e

II - para o período posterior a 16 de fevereiro de 2012: seguirá o Processo Produtivo Básico específico estabelecido em Portaria Interministerial.

Art. 3º As placas de circuitos impressos montadas com componentes elétricos e eletrônicos, denominada HWIC (High-Speed WAN Interface Cards) (Placa de Alta Velocidade de Interface WAN), utilizada exclusivamente em ROTEADOR DIGITAL

para rede sem fio, e que possuem a função descrita no parágrafo único, deverão ser montadas conforme cronograma:

I - de 1º de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012: dispensado;

II - de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013: 40% (quarenta por cento); e

III - de 1º de janeiro de 2014 em diante: 90% (noventa por cento).

Parágrafo único. As placas a que se refere este artigo têm como função permitir aplicações de acessos WAN pelos protocolos EIA-232, EIA-449, V.35, X.21 na configuração DTE e DCE, e EIA-530 e EIA-530^a na configuração DTE, com possibilidade de acesso por servidor discado, através de conector do tipo serial smart, cuja velocidade por portas é de até 8Mbps e distância máxima de acesso de 1.250 metros.

Art. 4º As placas de circuitos impressos montadas com componentes elétricos e eletrônicos, compondo módulo de processamento de sinais digitais (DSP), para voz e vídeo com capacidade igual ou superior a 16 canais, de alta densidade (PVDM), própria para montagem em soquete DIMM-240, utilizada exclusivamente em ROTEADOR DIGITAL para rede sem fio, deverão ser montadas conforme cronograma:

I - de 1º de julho de 2012 a 31 de dezembro de 2012: dispensado;

II - de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013: 40% (quarenta por cento); e

III - de 1º de janeiro de 2014 em diante: 90% (noventa por cento).

Art. 5º As FONTES DE ALIMENTAÇÃO utilizadas em: ROTEADORES DIGITAIS para rede sem fio; SWITCHES; TERMINAIS IP PARA TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE VOZ/DADOS (TELEFONES IP); ADAPTADORES DE TELEFONE ANALÓGICO PARA REDE IP (ATA); e MODULADORES/DEMULADORES (ADSL) deverão ser montadas conforme cronograma:

I - de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013: 30% (trinta por cento); e

II - de 1º de janeiro de 2014 em diante: 80% (oitenta por cento).

Parágrafo único. No ano de 2013 e exclusivamente para as fontes externas de alimentação utilizadas em MODULADORES/DEMULADORES (ADSL), o percentual constante do inciso I será de 10% (dez por cento), passando a 80% (oitenta por cento) a partir de 2014 em diante.

Art. 6º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim, o determinarem, a realização de qualquer etapa do Processo Produtivo Básico poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência, Tecnologia e Inovação.

Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCTI nº 162, de 27 de junho de 2012.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL
Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
MARCO ANTONIO RAUPP
Ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação

(*) Redação com retificações publicadas no DOU de 06.03.13